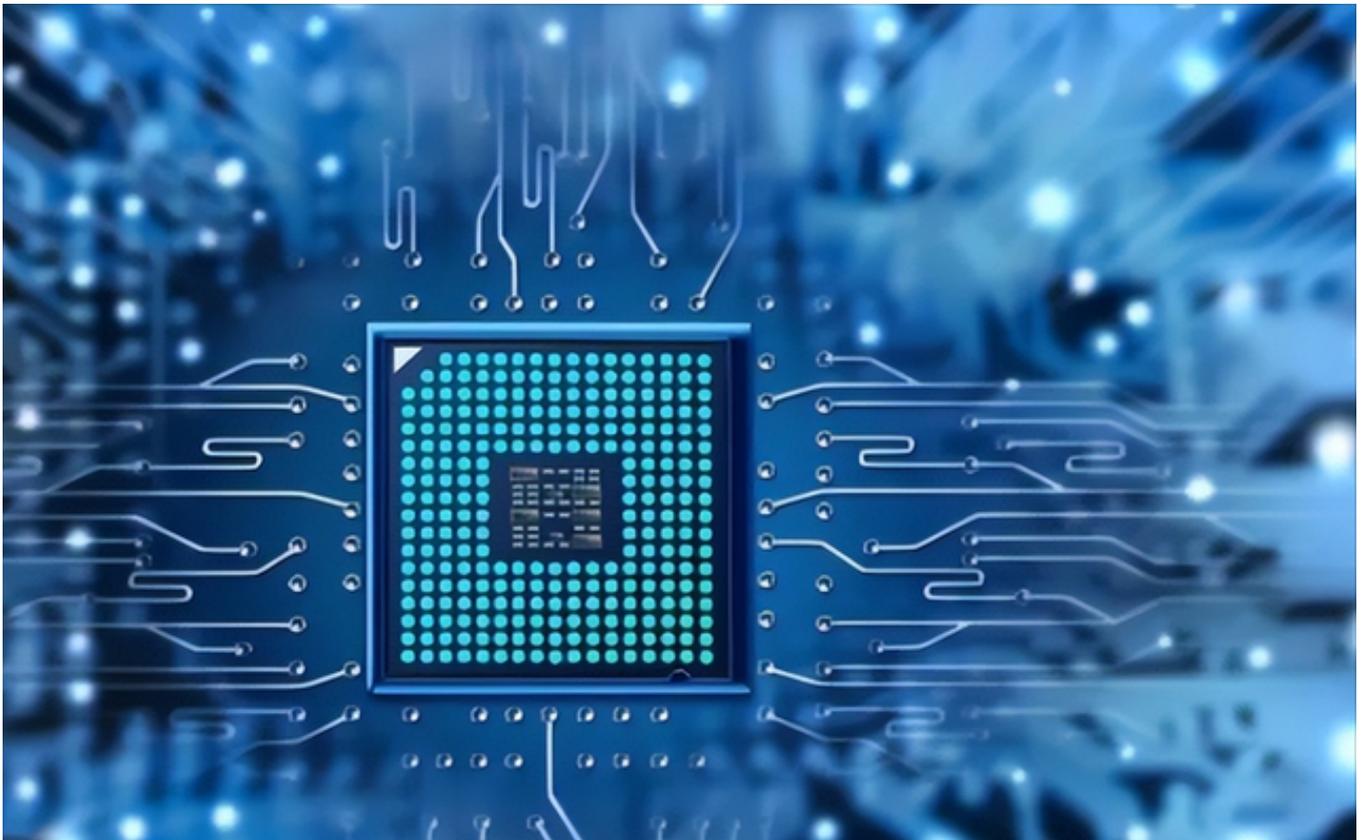


250亿美元的金额！四家芯片厂的大举自建产能 台积电受到伤害了？

尽管芯片产业正处于下行周期，但英飞凌、瑞萨、德州仪器、Rapidus四家IDM厂仍在积极扩产。根据台湾经济日报的报道，此次四家大厂投入的金额预估达到250亿美元（2月15日-2月16日）。



英飞凌已获准在德国德累斯顿建设一座价值50亿欧元（53.5亿美元）的芯片工厂，计划于2026年投产。英飞凌表示，这将是它历史上最大的单笔投资，该工厂将生产功率半导体和模拟/混合信号组件。

瑞萨电子表示，车用产品库存仍低于公司目标水准，为降低未来对车厂和其他重要客户的供应链中断风险，考虑扩大日本以外地区的芯片产能。

德州仪器计划在美国犹他州李海（Lehi）建造第二座12英寸半导体晶圆制造厂，这是该公司在犹他州110亿美元投资的一部分。新工厂预计将加入德州仪器现有的12英寸晶圆制造厂阵营，预计于2023年下半年开始建造，最早于2026年投产。

由日本国家支持的芯片企业Rapidus正考虑在日本北海道建设第一家制造厂，最早可能会在2月底正式决定新工厂选址。

这些芯片厂之外，台积电、英特尔、格芯、中芯国际、华虹半导体、Wolfspeed、美光、意法半导体等要么披露了扩产计划，要么已有新工厂处于建设中。

芯片大厂“反其道行之”台积电“受伤”？

目前所有信息均表明，芯片行业景气度持续低迷，曾经炙手可热的晶圆制造商也不能独善其身。据东兴证券近期研报，半导体下游终端需求萎缩，长约承诺导致wafer bank（客户寄放库存）位居高位。另据群智咨询数据，预计全球主要晶圆厂2023Q2行业稼动率将到达谷底（约75%）；晶圆代工整体价格策略已开始调整，预计2023年晶圆代工整体行业价格同比下降约10%-15%之间。

反观芯片大厂们，扩产新计划层出不穷，并致力于自建晶圆制造厂。即将接棒德州仪器总裁及首席执行官的现任执行副总裁及首席运营官Haviv Ilan甚至表示：“现在正是我们进一步扩大自有制造能力的最佳时机。”

这是为何？综合来看，大厂们或许出于以下考虑：

晶圆代工板块此前享受了行业产能短缺带来的高议价权，无论是刚经历完“加价抢产能”的芯片设计公司，还是曾经释出大量外包订单的IDM厂商，无一不认可制造端的价值。

从政府层面看，如今各区域打造本土完整产业链的意图更加明确，其中美欧均将先进的晶圆厂视作重振芯片制造业的关键，并颁布法案以提高芯片制造能力，欧洲法案将动员超过430亿欧元（相当于490亿美元）的资金，美国法案则要提供520亿美元的拨款。

这意味着，当地的晶圆制造厂有望享受更多的财政补贴。

另外，从晶圆厂启动建设到投产，一般需要2-3年，半导体景气度或将在这段时间内走出“至暗时刻”。据台积电预计，半导体库存于2022第3季达到高峰，预计2023年下半年产能利用率全面回升。天风证券表示，展望2023年，随着行业主动去库完成，以及需求端受益于开放政策的复苏，晶圆代工行业或将迎来基本面筑建相对底部的一年。

不过，随着更多晶圆制造产线启动建设，曾经的“无冕之王”——代工厂商们或将受到冲击。

全球汽车芯片市场中，英飞凌为业界龙头，瑞萨、德仪分居第三、四位，这三家厂商是采用IDM模式，并有类比芯片、微控制器等产品，过往多委由台积电、联电等晶圆代工厂生产。

据台湾经济日报报道，随着这些IDM厂大举兴建自有产能，未来车用芯片供应或更顺畅，但也会削减委外代工订单，影响台积电、联电等接单。

尽管芯片产业正处于下行周期，但英飞凌、瑞萨、德州仪器、Rapidus四家IDM厂仍在积极扩产。根据台湾经济日报的报道，此次四家大厂投入的金额预估达到250亿美元（2月15日-2月16日）。

本文链接：<https://dqcm.net/zixun/16766324749373.html>